

スマートプロセス学会誌

目 次 Vol. 8 No. 5 2019 (令和元年 9 月)

Mate2019 特集号—第 25 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

会 告 N19

巻 頭 言 Mate2019 特集号によせて
西川 宏 161

研 究 論 文 非晶質薄膜を介した銅と封止樹脂の接合
山田由香・伊関 崇 162

ダイアタッチプロセスにおける熱揺らぎが実装精度に及ぼす影響
櫻井大輔・浜平 大・那須 博
福本信次・藤本公三 169

酸化銀分解反応を用いた銀 - シリコン接合における界面形成過程
松田朋己・伊波康太・本山啓太
佐野智一・廣瀬明夫 177

樹脂の硬化収縮による物性変化を反映させた回路基板の反り予測技術
長岡秀明・古山昌治・赤星知幸・水谷大輔
作山誠樹・長竹真美・伊東伸孝 184

不良率がエネルギー原単位に及ぼす影響の評価
堀川貴正・日比野浩典・新井俊悟・山口 誠 190

単結晶ピスマスにおける双晶回復挙動
坂居貴雅・苅谷義治・渡邊裕彦・外薮洋昭 198

低弾性率中間層を導入した硬質樹脂封止型パワーモジュール内部の
応力 - ひずみ評価
多谷本真聡・福本信次・松嶋道也・藤本公三 205

一 般 論 文 Optical Measurement of Surface Temperature Distribution of Weld
Pool in AC Tungsten Inert Gas Welding of Aluminum A1050
Quang Ngoc TRINH, Huy Le PHAN, Shinichi TASHIRO
Van Hanh BUI and Manabu TANAKA 213

拡散性水素低減トーチのガス流体解析
田代真一・迎井直樹・井上芳英
Anthony B. MURPHY・菅 哲男・田中 学 219

報 告 記 事 エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム
(Mate2019) 開催報告
松嶋道也 225

会報・掲示板 N20

Journal of Smart Processing
Vol. 8 No. 5 2019 (September 2019)

CONTENTS

Mate2019 特集号—第 25 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

S.P.S. Announcement N19

Preface..... Hiroshi NISHIKAWA..... 161

Research Papers

Bonding of Mold Resin to Copper Substrate through an Amorphous Interlayer Film
Yuka YAMADA and Takashi ISEKI..... 162

Influence of Thermal Fluctuation on Bonding Accuracy in Die-Attach Process
Daisuke SAKURAI, Masaru HAMAHIRA, Hiroshi NASU,
Shinji FUKUMOTO and Kozo FUJIMOTO..... 169

Formation Process of the Interface in the Ag/Si Joints by the Decomposition Reaction of Ag₂O
Tomoki MATSUDA, Kota INAMI, Keita MOTOYAMA
Tomokazu SANO and Akio HIROSE..... 177

Thermal Warp Simulation in Substrate with Properties Change of Curing Resin
Hideaki NAGAOKA, Masaharu FURUYAMA, Tomoyuki AKAHOSHI,
Daisuke MIZUTANI, Seiki SAKUYAMA,
Mami NAGATAKE and Nobutaka ITOH..... 184

Evaluation of the Influence of Defective Rate on Specific Energy Consumption
Takamasa HORIKAWA, Hironori HIBINO,
Syungo ARAI and Makoto YAMAGUCHI..... 190

Detwinning Behavior of Bismuth Single Crystals
Takamasa SAKAI, Yoshiharu KARIYA,
Hirohiko WATANABE and Hiroaki HOKAZONO..... 198

Evaluation of Stress-strain State in Power Module Sealed with Hard Resin
Containing an Interlayer with Low Elastic Modulus
Masato TAYAMOTO, Shinji FUKUMOTO,
Michiya MATSUSHIMA and Kozo FUJIMOTO..... 205

General Thesis

Optical Measurement of Surface Temperature Distribution of Weld
Pool in AC Tungsten Inert Gas Welding of Aluminum A1050
Quang Ngoc TRINH, Huy Le PHAN, Shinichi TASHIRO
Van Hanh BUI and Manabu TANAKA..... 213

Numerical Simulation of Gas Flow in a Novel Torch for Reducing Diffusible Hydrogen
Shinichi TASHIRO, Naoki MUKAI, Yoshihide INOUE
Anthony B. MURPHY, Tetsuo SUGA and Manabu TANAKA..... 219

Special Report for Mate 2019

Report on 25th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
Michiya MATSUSHIMA..... 225

S.P.S. News N20